

# サーマルブリッジテクノロジー： 優れた熱耐性に よって稼働時間の最大化を実現



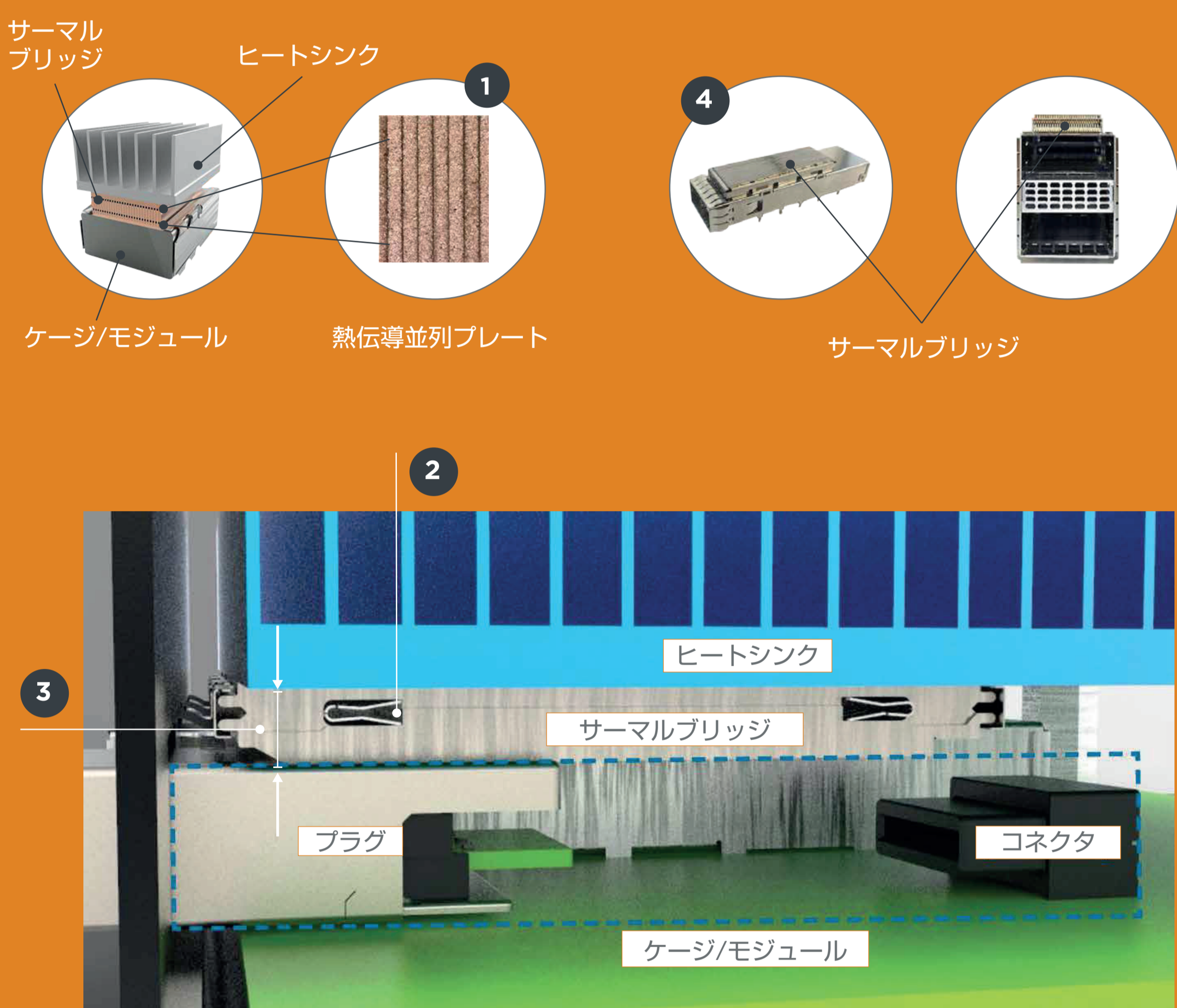
現在のデータコミュニケーションアプリケーションには、さらなるシステム電力が必要とされてきており、これにはより効果的な放熱手段が求められます。上乘せのヒートシンクなどの従来の放熱管理では、限られたエアフロー、液冷方式または冷却プレートといったアプリケーションに対する最適なソリューションが提供されるとは限りません。この問題への新たなアプローチが存在するならばどうでしょうか？

TEの画期的なサーマルブリッジテクノロジーにより、ギャップパッドやサーマルパッドなどの従来の放熱テクノロジーに比べて最大2倍の熱抵抗を実現します。このソリューションは、増大するシステム電力要件、特に制限のあるエアフロー、液冷方式、冷却プレートによる固定された冷却アプリケーションにおいて、さらなる放熱性を実現すべく開発されました。

01

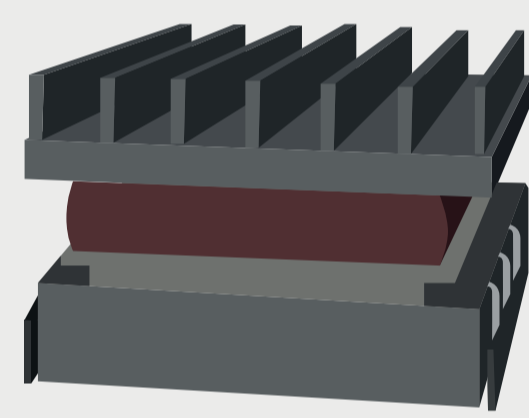
## サーマルブリッジの動作原理

1. 高密度で並列して出入りするプレートにより、I/Oモジュールから冷却エリアへ熱が伝達されます
2. 内蔵のスプリング機構により、インタフェース応力および圧縮長さ 1.0mmの行程が実現します。
3. プレートギャップがほぼなく、圧縮機能および熱伝導に対応
4. I/Oケーシング上に組込済み

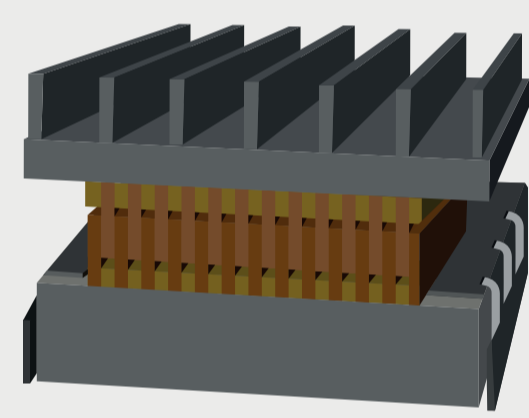


02

## サーマルパッドVSサーマルブリッジ



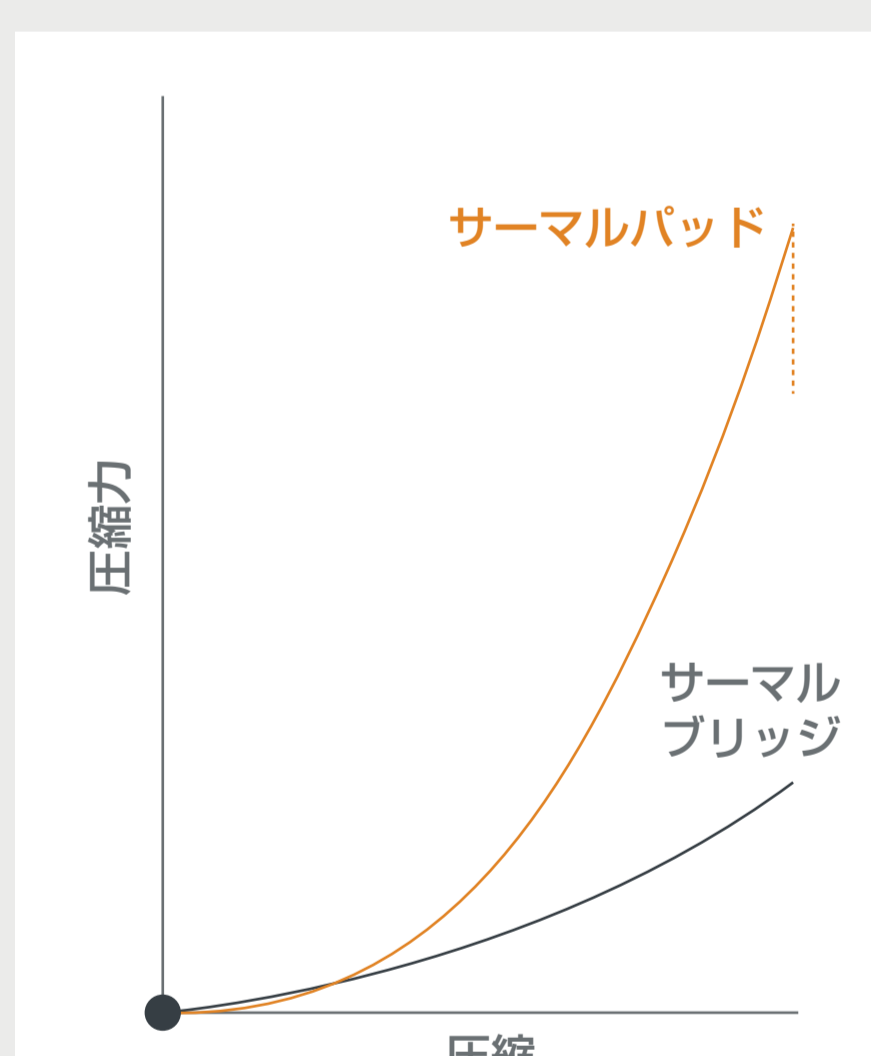
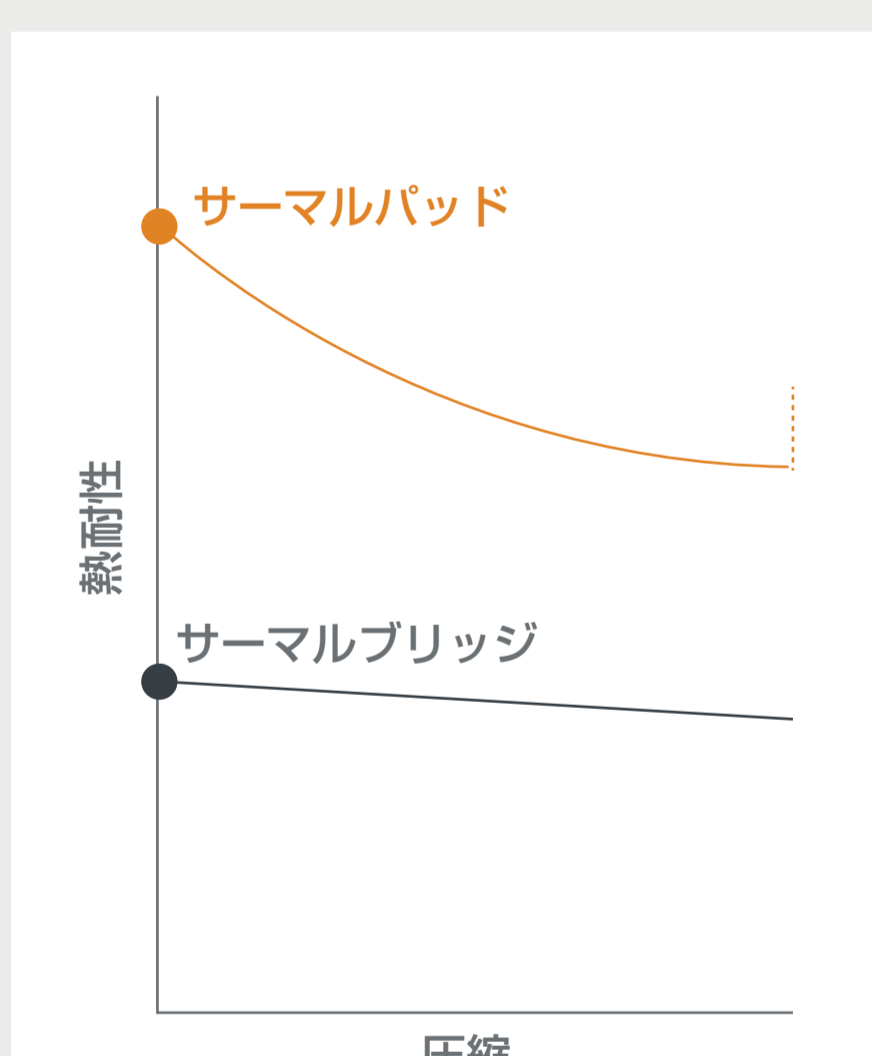
サーマルパッド



サーマルブリッジ

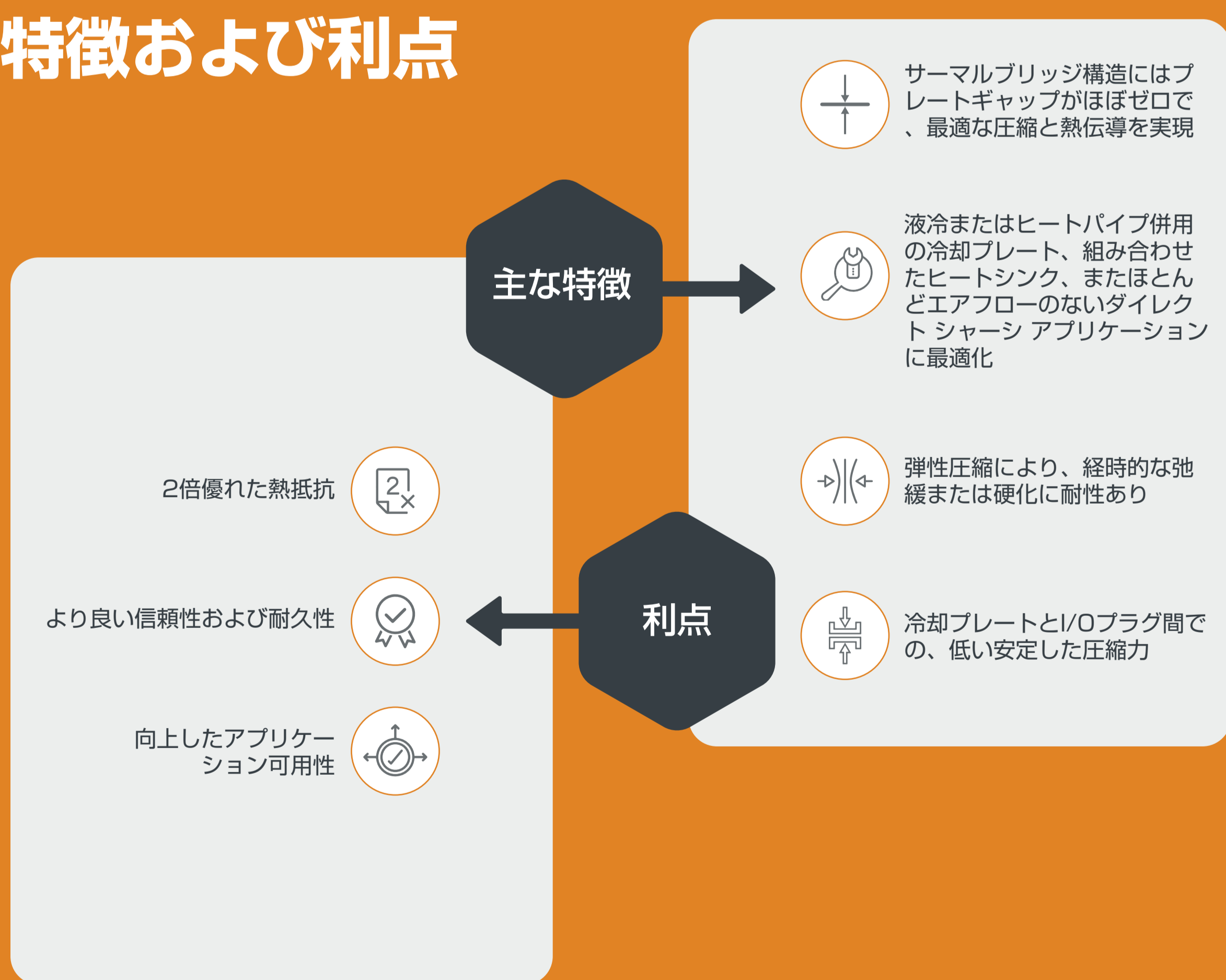
VS

放熱性能実現するには、厳しい公差管理と圧縮が必要	積み上げ時の公差を吸収するため、1mmの圧縮量を備え、内蔵スプリングにより外付けの圧縮ハードウェアは不要
材料厚さが各圧縮サイクルの影響を受ける	弾性圧縮により、経時的な弛緩または硬化に耐性があります
摩耗防止にさらなるコンポーネントが必要	ケーシング上に組込済み
一時的な使用 - 交換が必要	再使用可能 - 交換は不要



03

## 特徴および利点



04

## 応用場面



ハイパフォーマンスコンピューティング (HPC)



イーサネットスイッチ



5G/ワイヤレス



サーバ



イーサネットSP/Routing